

Title (en)

PROCESS FOR MANUFACTURING PLATED HOLLOW BLOCKS.

Title (de)

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON PLATTIERTEN HOHLBLÖCKEN.

Title (fr)

PROCEDE POUR FABRIQUER DES LINGOTS CREUX PLAQUES.

Publication

**EP 0472546 A1 19920304 (DE)**

Application

**EP 90906879 A 19900508**

Priority

- DE 3916114 A 19890516
- DE 9000335 W 19900508

Abstract (en)

[origin: WO9014446A1] Process for manufacturing internally plated hollow blocks for subsequent processing to seamless metal tubes, in particular steel tubes. To obtain a process with which a hollow block plated only on the inside can be manufactured and which obviates the conventional drawbacks, a cylindrical hollow body made from the plating material is immersed in a molten carrier material, a plating layer of sufficient thickness is deposited by crystallization and the hollow body is then removed from the melt. During immersion, the inner surface of the hollow body is protected to prevent penetration of the melt.

Abstract (fr)

Procédé pour fabriquer des lingots creux plaqués à l'intérieur en vue de leur transformation ultérieure en tubes métalliques sans soudure, notamment des tubes acier. Pour obtenir un procédé qui permette de fabriquer un lingot creux plaqué uniquement à l'intérieur et qui évite les inconvénients usuels, un corps creux cylindrique constitué du matériau de placage est immergé dans un matériau de support en fusion, une couche de placage d'épaisseur suffisante est déposée par cristallisation et le corps creux est ensuite retiré du bain. Pendant l'immersion, la surface intérieure du corps creux est protégée afin d'empêcher la pénétration de matière en fusion.

IPC 1-7

**C23C 2/00**

IPC 8 full level

**B22D 23/04** (2006.01); **C23C 2/00** (2006.01); **C23C 2/38** (2006.01)

CPC (source: EP KR US)

**C23C 2/00** (2013.01 - EP US); **C23C 2/006** (2013.01 - EP US); **C23C 2/29** (2022.08 - KR); **C23C 2/38** (2013.01 - KR)

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

**WO 9014446 A1 19901129**; AT E115643 T1 19941215; BR 9007180 A 19920128; CA 2033079 A1 19901117; CA 2033079 C 19981229; CN 1028847 C 19950614; CN 1047235 A 19901128; DE 59008036 D1 19950126; EP 0472546 A1 19920304; EP 0472546 B1 19941214; JP 2925093 B2 19990726; JP H04505184 A 19920910; KR 920700304 A 19920219; KR 930010337 B1 19931016; US 5232740 A 19930803

DOCDB simple family (application)

**DE 9000335 W 19900508**; AT 90906879 T 19900508; BR 9007180 A 19900508; CA 2033079 A 19900508; CN 90102770 A 19900512; DE 59008036 T 19900508; EP 90906879 A 19900508; JP 50690090 A 19900508; KR 900702693 A 19901228; US 77630691 A 19911113